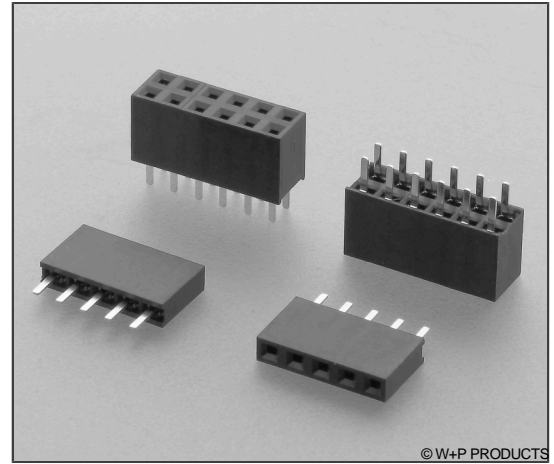


## Buchsenleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-reihig – BH 7,1/8,5mm Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double Row – 7.1/8.5mm Profile

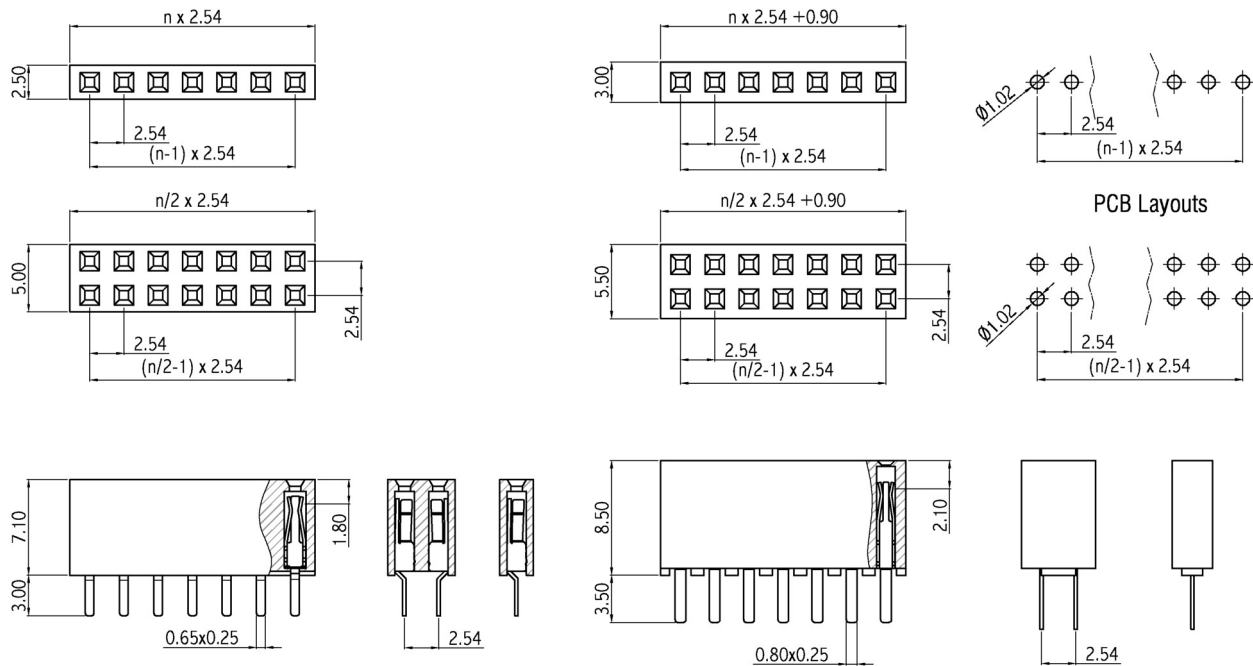
### Technische Daten / Technical Data

|  |   |
|--|---|
| Isolierkörper<br><i>Insulator</i>                            | Thermoplast, nach UL94 V-0<br><i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>  |
| Kontaktmaterial<br><i>Contact Material</i>                   | Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung<br><i>Contact for square pin 0.635mm, copper alloy</i>       |
| Kontaktoberfläche<br><i>Contact Surface</i>                  | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)<br><i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c<br><i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i> | keine<br><i>none</i>  |
| Durchgangswiderstand<br><i>Contact Resistance</i>            | < 20 mΩ<br><i>&lt; 20 mΩ</i>  |
| Isolationswiderstand<br><i>Insulation Resistance</i>         | > 1000 MΩ<br><i>&gt; 1000 MΩ</i>  |
| Spannungsfestigkeit<br><i>Test Voltage</i>                   | 500 V AC<br><i>500 V AC</i>   |
| Nennspannung<br><i>Voltage Rating</i>                        | 250 V AC<br><i>250 V AC</i>   |
| Nennstrom<br><i>Current Rating</i>                           | 3 A<br><i>3 A</i>   |
| Temperaturbereich<br><i>Temperature Range</i>                | -40 °C ... +125 °C<br><i>-40 °C ... +125 °C</i>   |
| Verarbeitung<br><i>Processing</i>                            | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren<br><i>Wave or reflow soldering</i>   |



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.  
*Dual beam contacts accept 0.635mm square pins.*



|               |   |   |  |  |
|---------------|---|---|--|--|
| <b>Series</b> | <b>Contacts*</b>  | <b>Rows*</b>  | <b>Type*</b>   | <b>Plating*</b>  |
| <b>624</b>    | <b>72</b>   | <b>2</b>  | <b>20</b>  | <b>60</b>  |
|               | 02-36 Einreihig<br><i>Single row</i><br>04-72 Zweireihig<br><i>Double row</i> | 1 Einreihig<br><i>Single row</i><br>2 Zweireihig<br><i>Double row</i> | 10 Bauhöhe 7,10mm<br><i>Height 7.10mm</i><br>20 Bauhöhe 8,50mm<br><i>Height 8.50mm</i> | 00 Vergoldet<br><i>Gold plated</i><br>50 Verzinkt<br><i>Tin plated</i><br>60 Sel. Au/Sn<br><i>Duplex plating</i> |

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

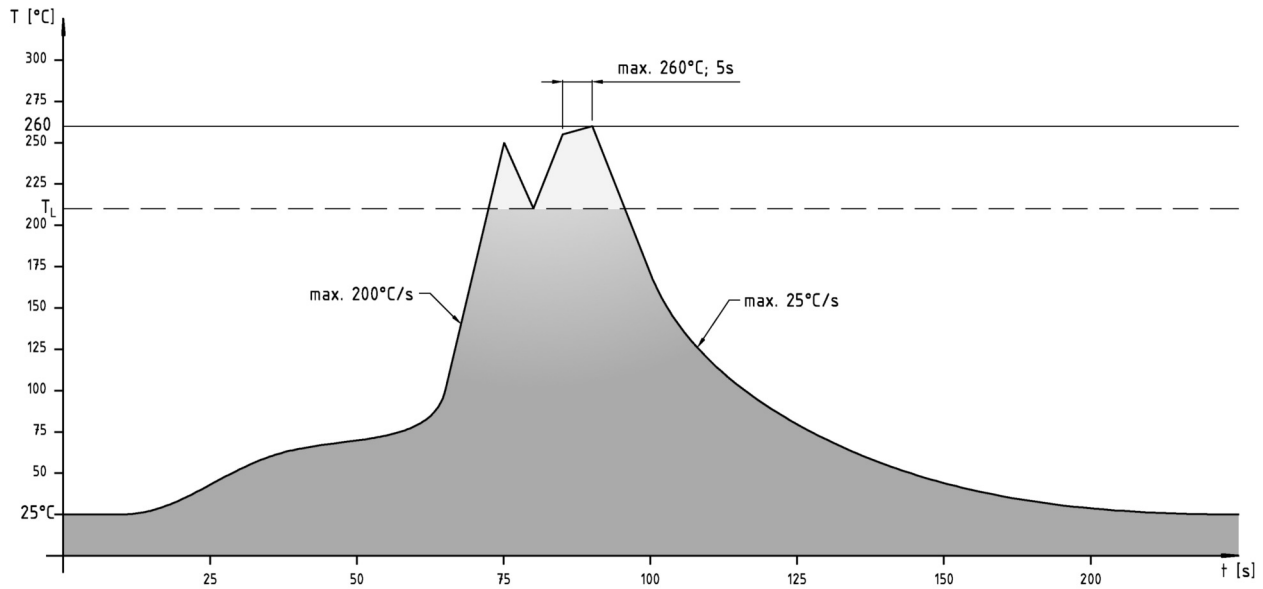
## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert      |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s     |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217 °C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260±5 °C      |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m       |

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values    |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s     |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217 °C        |
| Duration above $T_L$                 | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260±5 °C      |
| Duration Peak Temperature            | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min     |

